

## TP05/SP・DM (2008 Ed. 1)

### 通信用光部品・モジュールの動作中の振動衝撃試験法に関する調査

#### 概要

この技術資料は、特に MEMS 部品を内蔵する光モジュールの動作振動及び衝撃試験の調査結果をまとめたものである。動作振動衝撃試験方法の必要性の検討を行った。また、実際に MEMS 部品を内蔵する光モジュールの動作振動衝撃試験を行い、実使用状態を模擬し、典型的な光通信装置ラックへのボード挿入及びハンマー殴打試験を行った。さらに、構造シミュレーションを行った。試験結果及び構造シミュレーション結果の一致がみられた。これらの結果から、通信装置用光モジュールに対する動作振動衝撃試験条件の推奨値を検討した。